



ASML上调2026营收指引，芯原股份AI 订单占比超90%

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年07月21日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

ASML二季度业绩全面超预期，大幅上调2026年全年营收指引至450亿欧元

7月15日，光刻机巨头ASML发布2026年第二季度财报，受益于AI相关设备投资的强劲需求，业绩全面超出市场预期：净销售额93.26亿欧元，同比增长21.2%；毛利率54.0%，优于预期的52%；净利润29.18亿欧元，同比增长27.4%。从销售结构看，中国大陆净系统销售额占比进一步降至14%，韩国以43%居首，中国台湾占30%；逻辑制程与存储制程分别贡献51%和49%。ASML预计第三季度净销售额110亿至120亿欧元，远高于市场预期的约102.7亿欧元，并将2026年全年营收指引从360亿—400亿欧元大幅上调至430亿—450亿欧元，预计全年先进逻辑芯片收入增长约25%、存储芯片收入大幅增长约75%、Low NA EUV出货约65台并推动EUV业务收入增长约45%。为应对旺盛需求，ASML计划2027年将EUV和浸润式DUV产能各提升30%，并研究2028年再提升30%，目前2027年EUV订单已基本确定。此外，ASML宣布英特尔已在Intel 18A节点上采用High NA EUV量产Core Ultra 3系列处理器，成为业界首家将High NA EUV用于大规模逻辑产品制造的公司，标志着该技术成熟度的重要里程碑。

芯原股份年内新签订单达146.53亿元，AI算力相关订单占比超90%

7月16日，国产半导体IP大厂芯原股份发布自愿性披露公告，宣布2026年4月30日至7月16日期间新签订单达64.13亿元，其中AI算力相关及数据处理领域订单占比超过90%；叠加此前1月1日至4月29日新签的82.40亿元，公司2026年以来新签订单合计已达146.53亿元。芯原股份表示，新签订单绝大部分为一站式芯片定制业务订单，具备明确转化预期，但收入转化需要一定周期：芯片设计业务订单通常需9-12个月设计研发周期逐步实现收入转化，量产业务订单则受客户出货规划、晶圆厂产能排期等因素影响，从签约起通常需6-18个月完整生产交付周期。

建议关注：天数智芯、华虹宏力、惠科股份。

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-07-20 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
688347.SH	华虹宏力	309.00	0.01	0.51	0.83	30900.00	605.88	372.29	增持
9903.HK	天数智芯	495.20	-3.98	-1.78	0.89	-124.42	-278.20	556.40	买入
001399.SZ	惠科股份	23.51	0.58	0.63	1.31	40.53	37.32	17.95	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：港股股价和EPS货币单位为港元）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

7月13日-7月17日当周，海外龙头总体呈下跌态势。其中，大立光领涨，涨幅为1.52%，稳懋领跌，跌幅为18.10%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

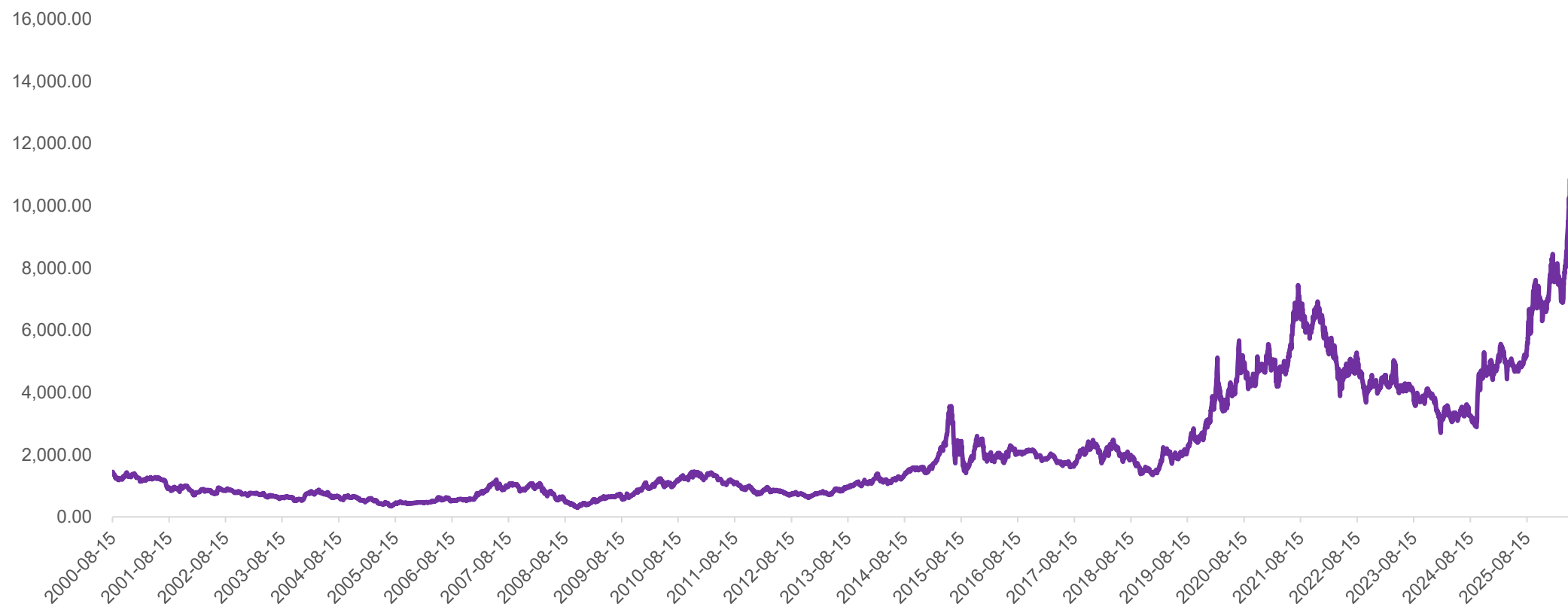
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值（亿元）	PE (LYR)	PB (MRQ)	周涨跌幅（%）
处理器	INTC.O	英特尔 (INTEL)	美国	4773.86	-1787.96	4.29	-13.47
	QCOM.O	高通 (QUALCOMM)	美国	1810.56	32.68	6.64	-9.19
	AMD.O	超威半导体 (AMD)	美国	8083.87	186.48	12.54	-11.14
	NVDA.O	英伟达 (NVIDIA)	美国	49080.02	40.88	25.11	-3.86
存储	MU.O	美光科技 (MICRON TECHNOLOGY)	美国	9587.98	112.28	9.52	-13.31
模拟	TXN.O	德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS)	美国	2584.85	51.98	15.41	-8.81
	ADI.O	亚德诺 (ANALOG)	美国	1828.33	80.64	5.42	-5.13
	AVGO.O	博通 (BROADCOM)	美国	17642.30	76.29	20.12	-7.29
	NXPI.O	恩智浦半导体 (NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	672.91	33.30	6.16	-8.80
射频	SWKS.O	思佳讯 (SKYWORKS)	美国	89.27	18.71	1.55	-1.71
	QRVO.O	QORVO	美国	75.42	22.25	2.26	-0.36
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	551.59	332.28	3.10	-13.15
	ON.O	安森美半导体 (ON SEMICONDUCTOR)	美国	342.41	282.98	4.69	-8.95
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	831.35	81.91	4.78	-12.17
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	5245.01	24.65	2.84	1.52
半导体设备	AMAT.O	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	4205.29	60.09	17.59	-12.09
	LRCX.O	拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	3918.04	73.12	37.02	-10.57
	KLAC.O	科天半导体 (KLA)	美国	2779.10	68.42	47.66	-8.11
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	6882.51	61.13	27.77	-2.77
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	5928.61	81.08	6.35	-8.15
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	669026.19	34.98	9.23	-5.18
	GFS.O	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	315.39	35.64	2.70	-16.66
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1409.60	83.22	3.44	-18.10
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	855.35	66.28	7.83	-9.96
分销	ARW.N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	105.65	18.49	1.57	0.10
	AVT.O	安富利 (AVNET)	美国	70.25	29.25	1.42	-1.70

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

7月13日-7月17日当周，申万半导体指数整体呈现大幅回调的态势。7月17日，申万半导体指数为10227.42，周跌幅为17.15%。

图表3：近5年申万半导体指数

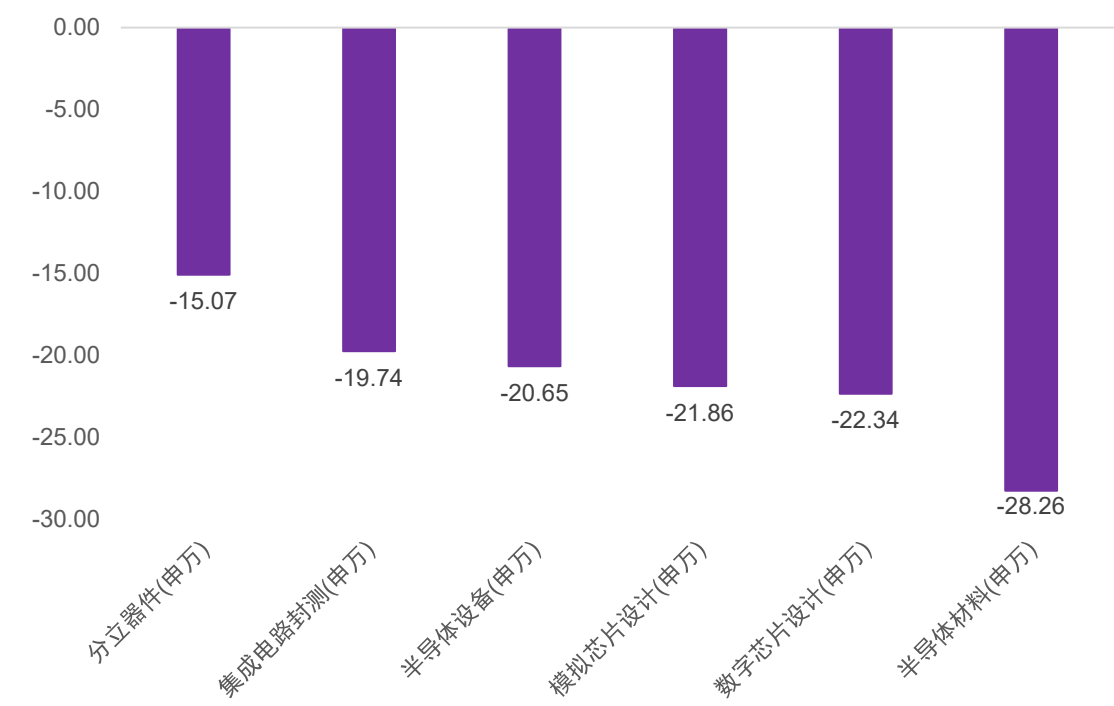


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

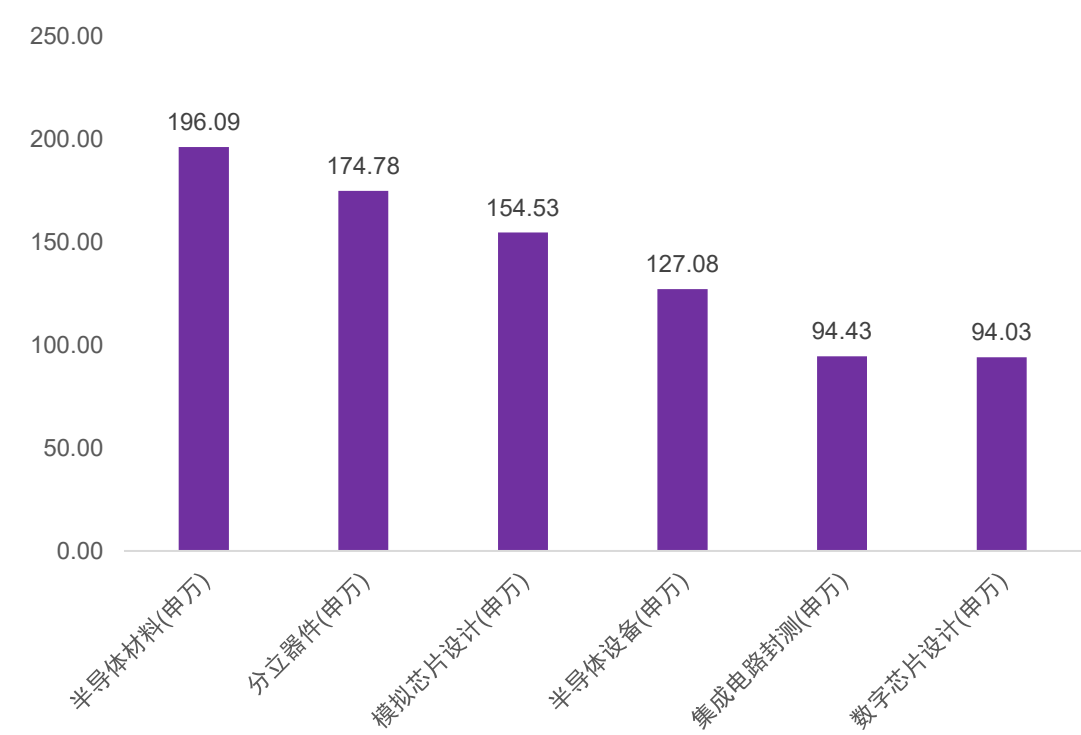
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，7月13日-7月17日当周，半导体细分板块呈下跌态势。其中，半导体材料板块跌幅最大，达到28.26%；分立器件板块跌幅最小，达到15.07%。估值方面，半导体材料，分立器件，模拟芯片设计板块估值水平位列前三。

图表4：7月13日-7月17日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：7月17日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：
其他电源设备板块主力净流出12.47亿元，主力净流入率为-1.29%，在9个二级子行业中排第1名；其他电子板块主力净流出79.80亿元，主力净流入率为-5.94%，在9个子行业中排第9名。

图表6：7月13日-7月17日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW其他电源设备 II	3,395,131.59	3,519,837.69	-124,706.10	-1.29	-3
SW通信设备	48,092,750.90	50,755,301.24	-2,662,550.34	-2.73	-3
SW半导体	106,155,341.48	113,630,508.42	-7,475,166.95	-3.02	-5
SW计算机设备	8,077,965.42	8,827,530.72	-749,565.30	-3.27	-5
SW航天装备 II	2,207,678.98	2,516,024.35	-308,345.38	-4.12	-5
SW消费电子	13,953,717.02	15,658,677.23	-1,704,960.20	-4.16	-5
SW军工电子 II	5,136,238.55	5,888,994.24	-752,755.69	-4.53	-5
SW电子化学品 II	7,464,982.89	8,535,971.71	-1,070,988.83	-4.54	-5
SW其他电子 II	4,721,037.83	5,519,073.36	-798,035.53	-5.94	-5

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

7月13日-7月17日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：普冉股份，艾森股份，中芯国际，龙图光罩，艾为电子，恒坤新材，华岭股份，屹唐股份，凯德石英，西安奕材周涨幅分别为：16.21 %，10.57 %，10.06 %，6.36 %，5.90 %，5.63 %，4.90 %，4.59 %，3.88 %，3.69 %。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值（亿元）	EPS			PE			PB	周涨跌幅（%）
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688766. SH	普冉股份	376. 41	2. 77	3. 39	3. 96	128. 73	105. 14	90. 05	15. 57	16. 21
688720. SH	艾森股份	65. 92	0. 38	—	0. 86	196. 92	—	86. 52	6. 40	10. 57
688981. SH	中芯国际	5089. 73	0. 46	0. 66	0. 81	94. 73	96. 87	79. 07	5. 37	10. 06
688721. SH	龙图光罩	52. 65	0. 69	—	—	57. 33	—	—	4. 34	6. 36
688798. SH	艾为电子	157. 64	1. 10	1. 51	2. 29	61. 85	44. 78	29. 52	3. 76	5. 90
688727. SH	恒坤新材	219. 85	0. 25	—	—	226. 86	—	—	8. 76	5. 63
920139. BJ	华岭股份	46. 19	-0. 06	—	—	-308. 30	—	—	4. 43	4. 90
688729. SH	屹唐股份	666. 77	0. 20	—	0. 29	123. 29	—	76. 83	7. 48	4. 59
920179. BJ	凯德石英	33. 74	0. 44	—	0. 64	83. 66	—	70. 28	4. 49	3. 88
688783. SH	西安奕材-U	884. 68	-0. 21	—	—	-119. 93	—	—	7. 12	3. 69

资料来源：wind，华鑫证券研究

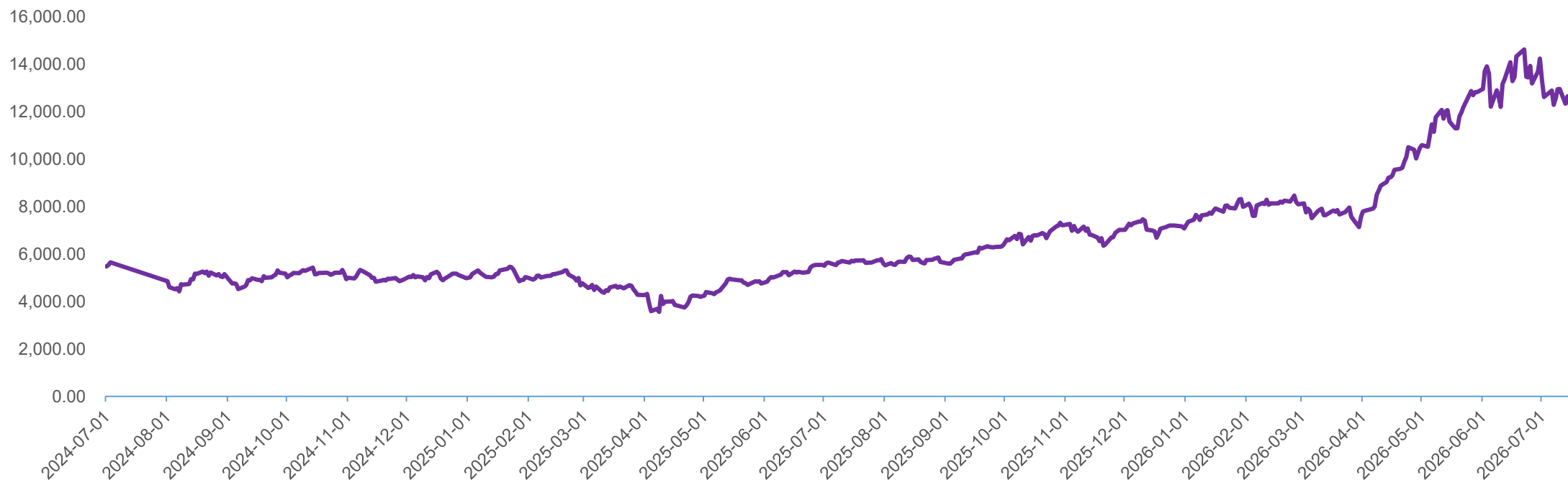
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，7月13日-7月17日当周，费城半导体指数总体呈现震荡下跌的态势，在2026年7月17日出现下跌至11673.89，近两周整体呈现震荡下跌的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。2026年七月以来，指数在7月初达到阶段高点后持续回落，7月中旬呈现加速下跌态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

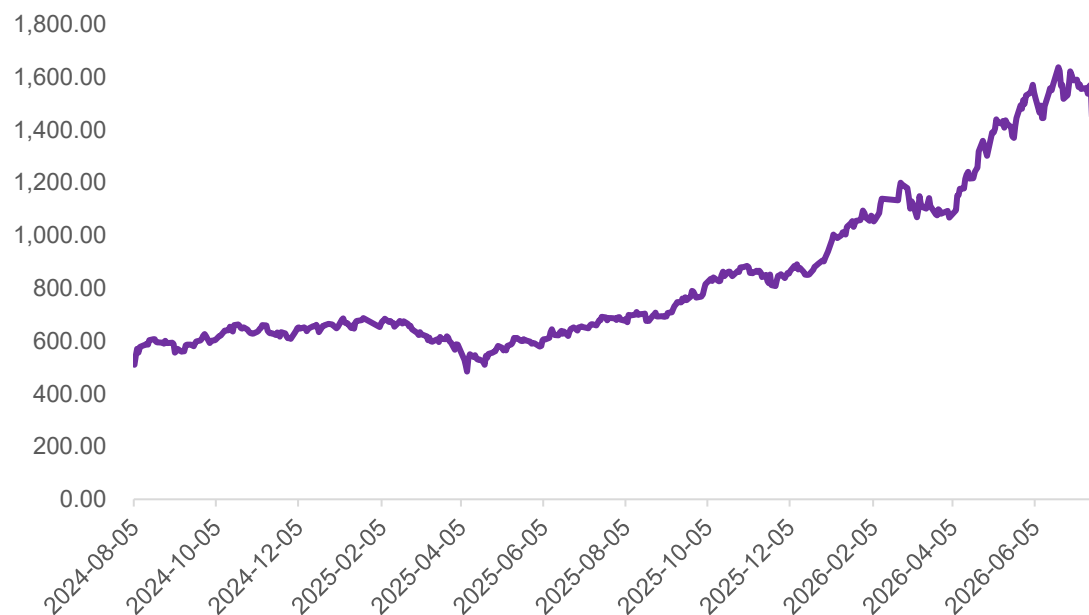


资料来源：wind，华鑫证券研究

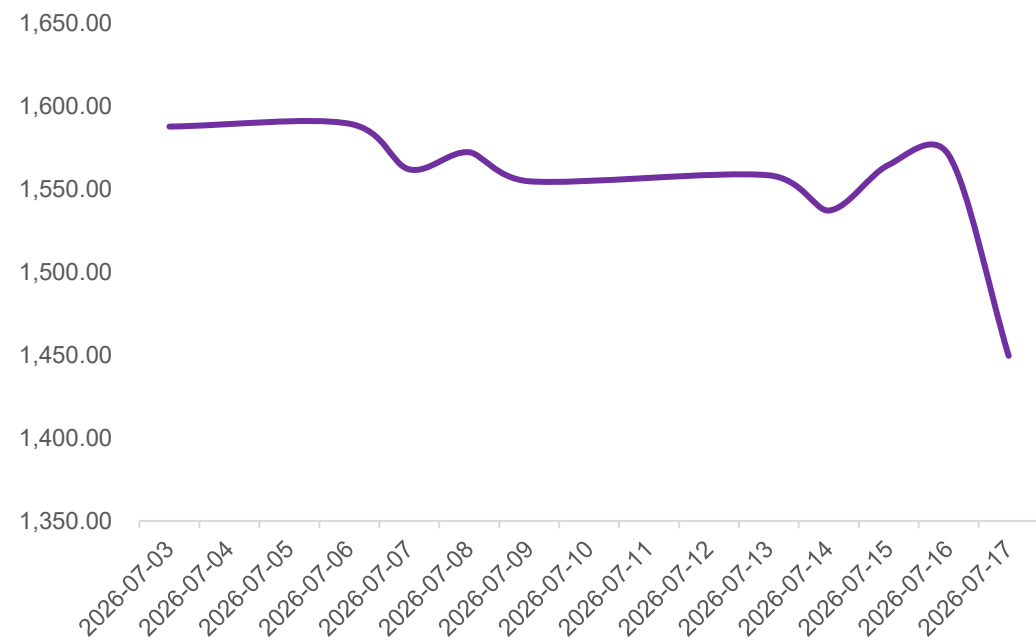
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，7月6日-7月17日两周，台湾半导体行业指数呈现整体下降的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。2026年七月以来，指数在月初达到阶段高点后持续回落，呈现震荡下跌态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



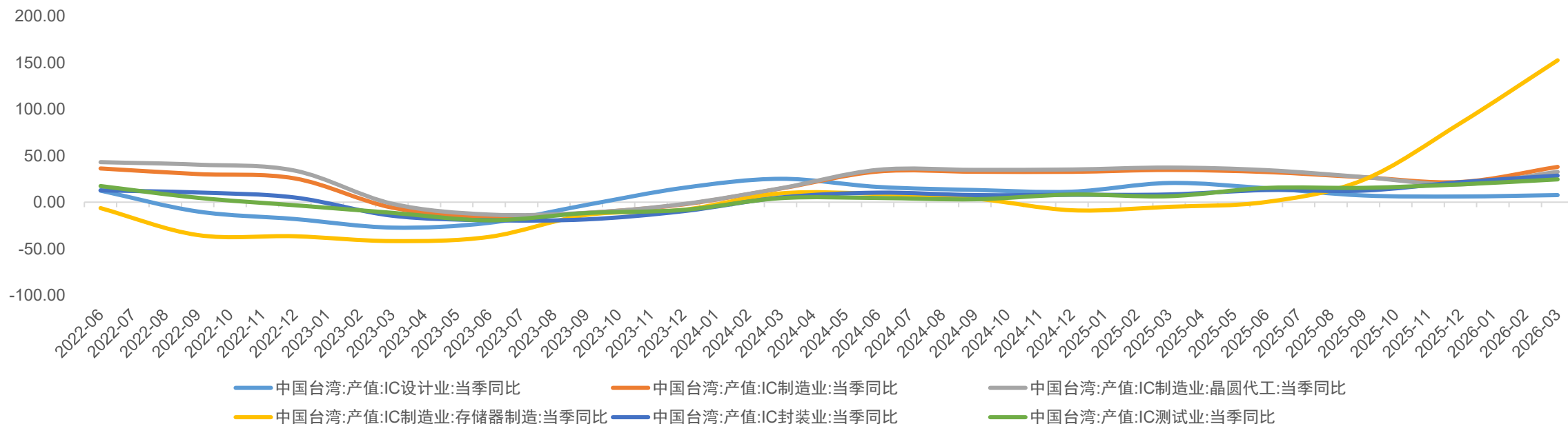
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。2026年一季度中国台湾IC各板块产值同比增速全面上行。在AI算力需求持续旺盛及存储器行业周期复苏的推动下，2026年Q1中国台湾IC产业景气度显著上行。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

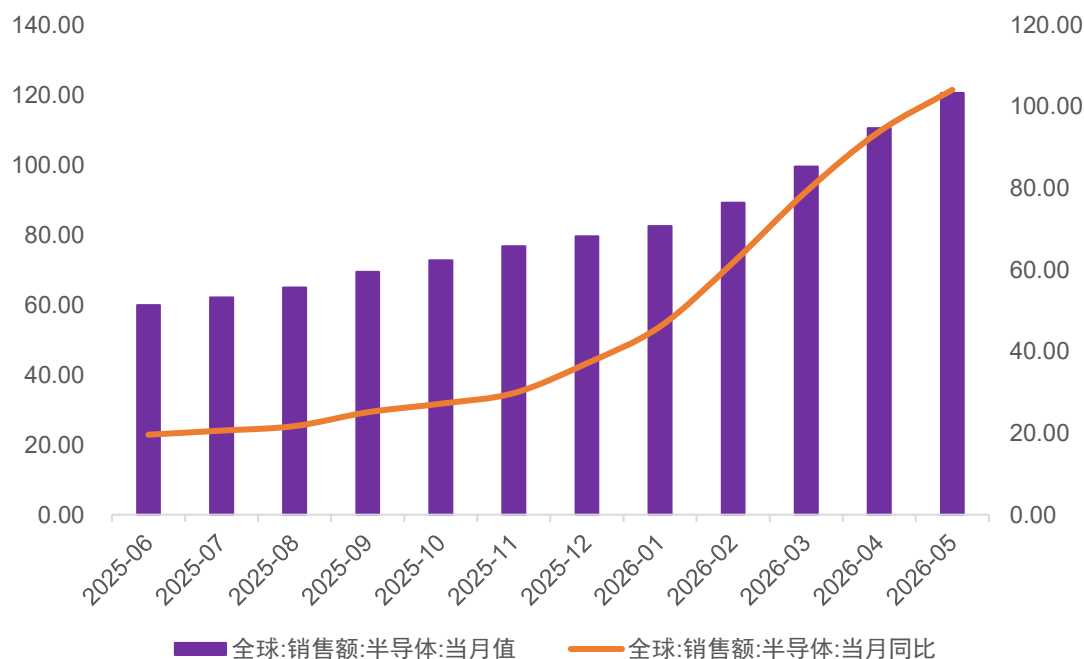


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年5月，全球半导体当月销售额为1206.10亿美元，同比增长104.10%。其中，中国销售额为319.70亿美元，环比增长10.70%，占比达26.51%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



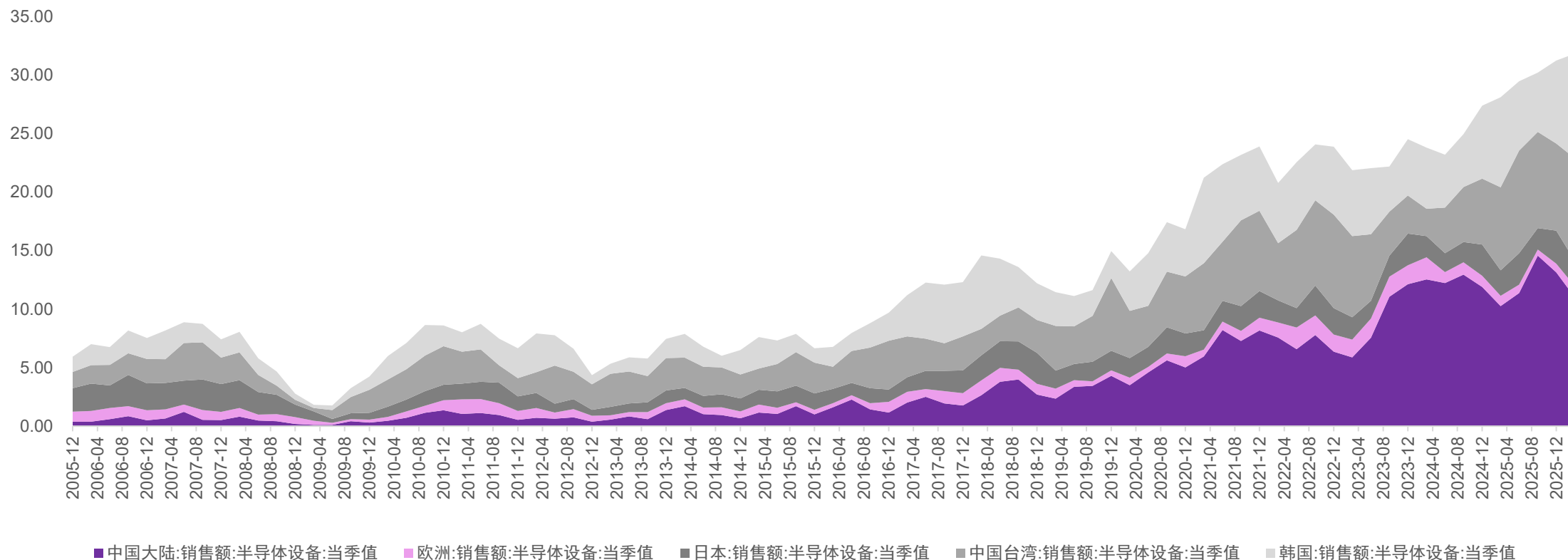
图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2026年一季度，中国大陆半导体设备销售额达到109.9亿美元，同比增长7.12%，环比下降16.30%，占全球主要地区比重达34.56%。

图表14：全球半导体设备销售额（十亿美元）

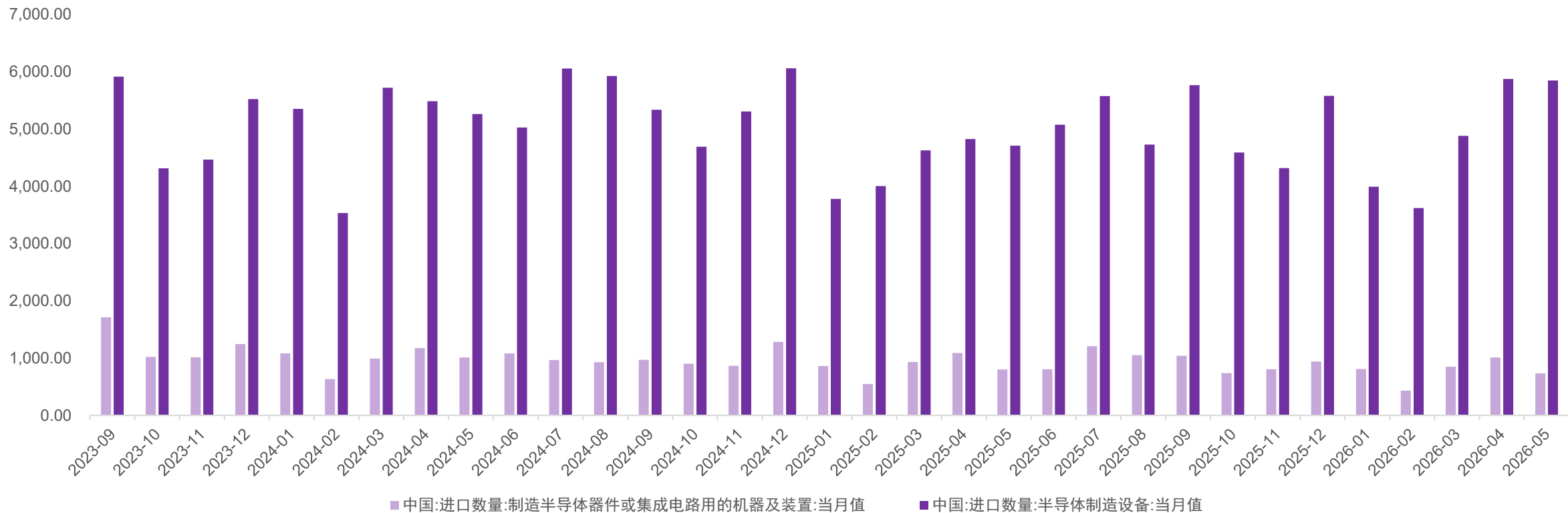


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。2026年1-2月进口数量阶段性回落，3月起持续回升，6月达7583台，4-5月连续两月维持在较高水平，显示国内晶圆厂扩产需求旺盛。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

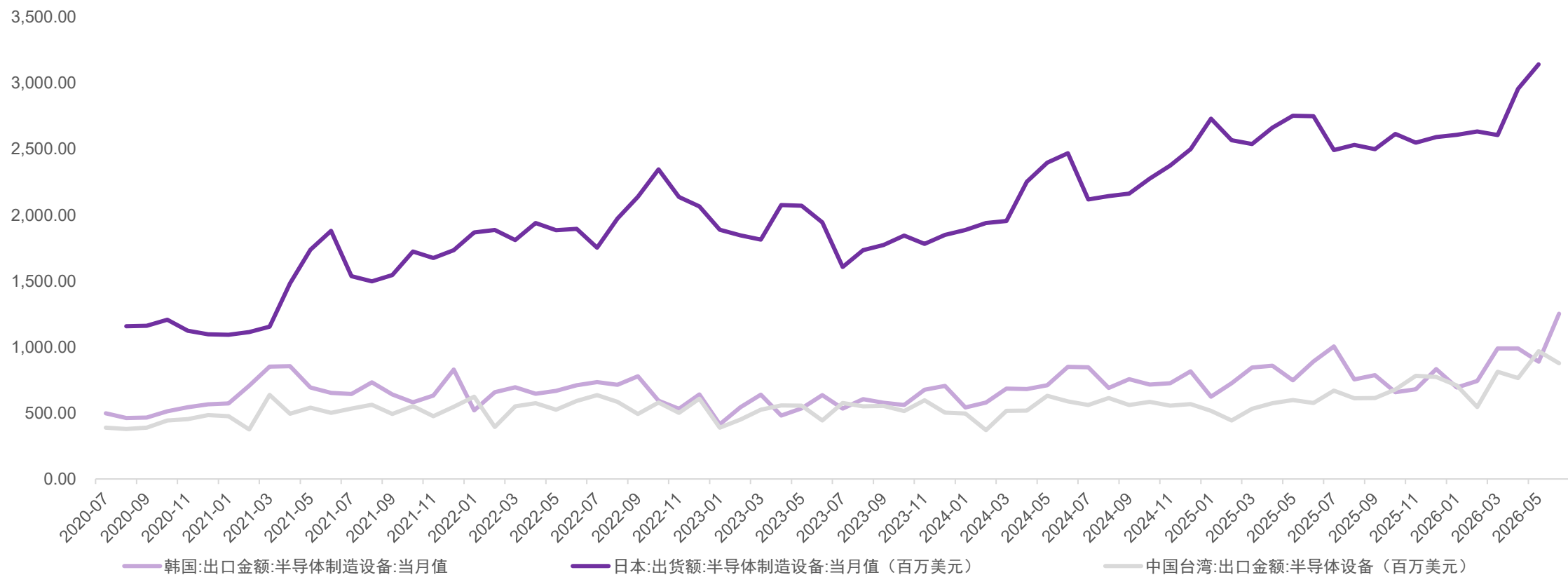


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。2026年以来，日本半导体设备出口额持续攀升并创阶段新高；韩国出口额近期大幅回升，中国台湾出口额高位有所回落。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

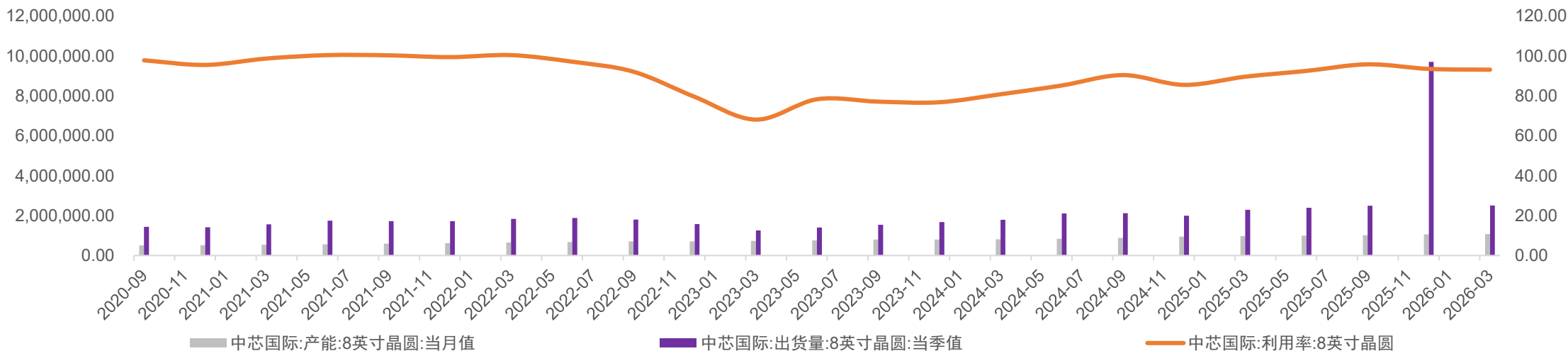
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。2026年一季度8英寸晶圆出货量达到约250.9万片，维持历史高位。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

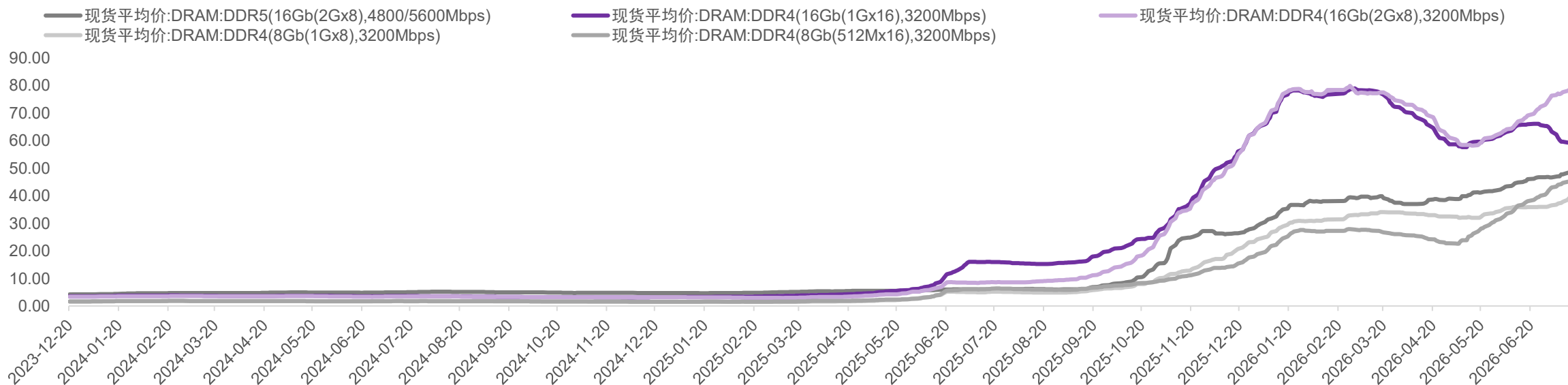


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年2月23日价格为17.95美元。DRAM方面：DDR5(16Gb,4800/5600Mbps)现货均价自2025年以来呈现大幅上涨态势，2026年3月初约39.67美元，此后延续上涨，截至7月17日价格已达49.67美元。DDR4各规格产品分化运行，16Gb(2Gx8)3200Mbps现货价由6月18日的69.13美元进一步升至7月17日的80.20美元，16Gb(1Gx16)3200Mbps现货价由6月18日的66.00美元回落至7月17日的59.17美元。整体来看，在AI需求拉动及供给端产能转向HBM的背景下，DRAM价格整体延续上涨态势，但部分规格出现高位回调。

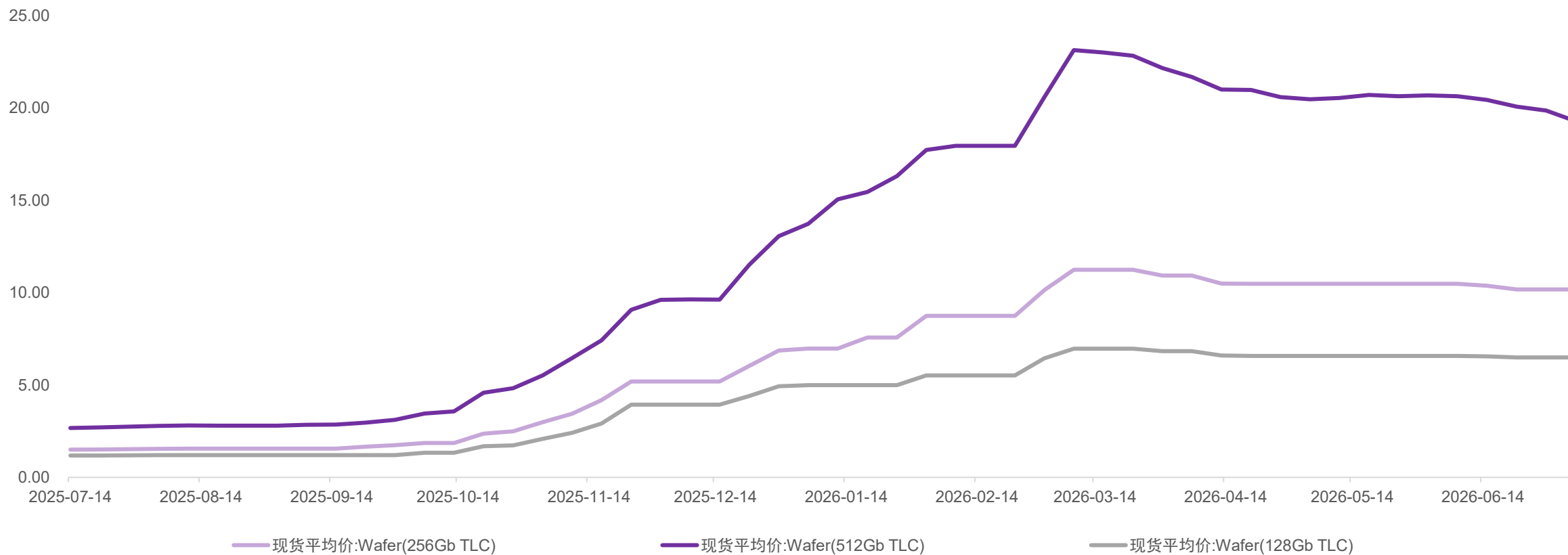
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

■ 华为昇腾950超节点亮相：1024卡，FP4算力2EFLOPS

7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心拉开帷幕。华为昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）首次公开亮相。该超节点应该是基于今年一季度推出的昇腾950PR，微架构将升级为SIMD/SIMT，算力达到1PFLOPS（FP8）/2PFLOPS（FP4），支持FP32/HF32/FP16/BF16/FP8/MXFP8/HiF8/MXFP4/HiF4等数据格式，互联带宽为2TB/s。内存容量和带宽上，昇腾950PR为144GB、4TB/s。昇腾950超节点是基于昇腾950PR与灵衢互联协议和超节点架构，实现业界最大1024卡规模，提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4澎湃算力，拥有256TB全局统一内存编址空间，依托TB级NPU互联超大带宽与3μs超低RTT时延，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。通过系统性架构创新优化，实现全域资源统一高效调度，让整套超节点集群高效运行。

除了昇腾950超节点，昇腾还带来了Atlas 850E风冷超节点现场展示。该产品依托自研VCE相变散热技术与灵衢互联协议，无需对现有风冷IDC机房做液冷基建改造，标准机柜可直接上架部署，实现把超节点技术部署到传统机房，支持单个风冷超节点扩展至96卡商用部署，为企业提供高吞吐、低时延、长序列的推理性能体验，支撑Agentic推理业务快速规模化落地。Atlas 850E原生覆盖FP8、mxFP8、HiF8、INT8、mxFP4全量低精格式，搭配4.0 TB/s高速内存带宽，可稳定实现10ms级时延推理，充分匹配Agent多轮对话、高频KV缓存读写的负载需求，实现多卡高效并行推理和内存资源池化，支持M级超长上下文。

台积电对美投资增至2650亿美元，再建4座晶圆厂

7月16日，晶圆代工大厂台积电召开了2026年二季度法人说明会。Q2业绩超预期，净利润同比大涨77.4%创历史新高，2nm制程也已开始贡献营收。台积电还宣布上调全年营收和资本支出，并回应了与三星和英特尔的竞争、先进封装、涨价等议题。更令人瞩目的是，台积电正式宣布对美国追加1000亿美元投资，使其在美国的总投资额将达2650亿美元。

台积电累计2026上半年营收达新台币24,044.84亿元，同比增长35.6%；毛利率为67%，同比提升8.3个百分点；归属母公司净利润为新台币12,790.42亿元，同比大涨68.3%；每股收益新台币49.32元。从各制程工艺的营收占比来看，2nm占比约3%、3nm占比30%、5nm占比33%、7nm占比11%，7nm及以下先进制程合计占比达77%。从应用领域来看，HPC营收环比增长20%，在总营收当中的占比高达66%；智能手机营收环比下滑4%，在总营收当中占比为22%；IoT营收环比增长4%，在总营收当中占比为5%；汽车相关营收环比增长15%，在总营收当中占比为4%；DCE营收环比增长5%，在总营收当中占比为1%；其他应用营收环比增长5%，在总营收当中占比为2%。台积电预计，第三季营收以美元计算约为446-458亿美元，其中间值环比增长12%，毛利率介于65-67%、营业利润率介于56-58%，汇率假设基础为1美元兑32新台币。

台积电董事长暨总裁魏哲家正式宣布，将在美国亚利桑那州追加1000亿美元投资，预计将再建置4座晶圆厂，以及先进封装厂，满足美国客户未来多年的强劲需求。此举将使台积电在美国的总投资额达到2650亿美元。除了扩大美国的产能之外，台积电也将继续扩大在中国台湾的产能。魏哲家强调，台积电未来几年同时将在中国台湾建设13座先进制程晶圆厂，继续在中国台湾发展壮大。台积电的技术和制造将持续协助客户实现创新。从全球布局来看，台积电计划新建的3座3nm晶圆厂，1座位于中国台湾，1座位于美国亚利桑那州，1座位于日本，以支持未来多年对3nm技术的强劲需求。此外，台积电还将在中国台湾改造原有的5nm厂，以支持3nm芯片生产。

力积电：DRAM代工价7月再涨45%、成熟制程同步调升

据力积电于7月14日召开法说会，总经理朱宪国表示，受惠 AI 需求持续强劲，存储器与成熟制程市场供需同步转紧，公司 7 月已再次调升 DRAM 投片价格约 40% 至 45%，8 英寸及 12 英寸成熟制程代工价格也上调约 10% 至 15%，预计涨价效益将自 11 月起逐步反映在营收与获利表现。

朱宪国指出，AI 运算需求持续扩张，全球大型云端服务供应商 (CSP) 已提前预订未来数年的 DRAM 产能，加上主要存储器厂近期财报表现亮眼，显示整体市场供需维持健康，预估 DRAM 供给吃紧情况可望延续至 2027 年。因应市场供需变化，力积电 7 月再次调升 DRAM 投片价格，涨幅约 40% 至 45%。不过，由于晶圆制造、出货及客户结算需要一定时间，相关价格调整不会立即反映，预计自 11 月起逐步挹注营收及获利，第四季效益可望较为明显。

制程升级方面，力积电自行研发的 1X DRAM 制程已于 6 月进入小量生产，目前持续改善良率并进行客户验证；与美光 (MU-US) 合作开发的 1P 制程，则预计明年第一季完成相关设备建置，目标于 2028 年中量产，逐步推动 DRAM 技术朝更先进节点发展。除 DRAM 外，Flash 市场也受到 AI 需求带动。朱宪国说，AI 服务器及 AI 终端装置需求成长，推升 SLC NAND 市场价格持续走扬；NOR Flash 则受惠供给结构调整，市场需求与价格均出现改善。力积电目前 NOR Flash 月投片量已突破 1 万片，并持续扩大接单，后续将陆续导入更具成本竞争力的 20 奈米制程及新世代产品，提升产品竞争力与获利表现。

Intel 18A良率升至85%，已获多家大厂订单

7月15日消息，根据外资投行KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh发布的最新研究报告显示，英特尔最先进的Intel 18A制程良率已突破85%，晶圆代工业务也获得了苹果、AMD、英伟达等头部客户的订单。EMIB-T先进封装良率高达98%，且将获谷歌、亚马逊导入。基于代工与封装业务的巨大增长潜力，KeyBanc首次给出英特尔2030年1320亿美元的营收预期，并将目标股价大幅上调至155美元。KeyBanc在最新的报告中指出，英特尔当前最关键的Intel 18A制程良率已从65%稳健提升至85%。虽然这一数字仍落后台积电N2（2nm）制程的90%的良率，但已明显超越三星晶圆代工

（Samsung Foundry）SF2（2nm）制程的50%~60%的良率表现。

受益于Intel 18A制程良率的大幅提升，再加上台积电先进制程涨价，KeyBanc 预测英特尔会将80%至90%的新一代桌面电脑处理器“Nova Lake”的计算芯粒交由内部代工。而此前外界预测，英特尔计划将Nova Lake约60%~70%的计算芯粒外包给台积电N2制程生产。

在拓展外部代工业务方面，英特尔计划将Intel 18A-P、Intel 18A-PT以及Intel 14A等先进节点提供给主要的商业服务提供给外部客户。英特尔CEO陈立武今年5月时曾表示，公司有信心在2026年下半年，顺利取得数家合作伙伴关于晶圆代工的正式承诺。

作为英特尔当前主推的能够与台积电CoWoS竞争的先进封装工艺，EMIB-T的良率也在持续改进。KeyBanc在报告中指出，目前EMIB-T良率已经达到了98%，高于三个月前被外界报道的90%。KeyBanc在最新的报告中还透露，英特尔在2026年第三季度将再次上调客户端CPU价格，涨幅为6%-15%。

由于外部客户的代工订单激增，以及代理型AI工作负载对服务器CPU需求激增，英特尔正在大幅扩大 Intel 18A和Intel 3制程工艺的产能。近日，英特尔已经宣布对其位于爱尔兰莱克斯利普的园区进行50亿欧元（约合57亿美元）的资本投资，以扩大其在爱尔兰晶圆厂的产能，提升交付基于Intel 3制程节点的至强6及下一代至强处理器的能力。KeyBanc指出，英特尔已成功在Intel 3工艺上扩大产能，以支持今年服务器芯片（主要是Granite Rapids）出货量25%-30%的同比增长，以及明年超过50%的增长。

长鑫存储股权激励、长鑫科技中签率公布

截至IPO前，长鑫两期员工持股计划累计覆盖6760人次，占公司总员工数19298人的35%，激励覆盖率超国内半导体制造企业平均水平。从人才结构来看，激励对象中研发人员占比超过30%，硕士及以上高学历人才占比接近40%。不同于多数企业股权激励向管理层、核心技术负责人倾斜的精英化逻辑，长鑫的持股体系实现技术研发、一线制造、工艺保障、运营支撑等全链条核心人才的均衡覆盖。

长鑫科技7月16日公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公布。本次发行价格为8.66元/股，网上发行有效申购户数为9,428,778户，有效申购股数为8169.20亿股。网上发行初步中签率为 0.40995452%。在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为217313.3388万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的36.07%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的28.25%；网上最终发行数量为385110.3500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的63.93%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的50.07%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.47141739%。

■ 日月光：砸20.3亿元买设备

日月光投控于7月17日晚间公告，取得营业用机器设备，交易总金额合约为11.11亿元。日月光今年因应人工智能（AI）与高性能计算（HPC）需求，持续加快先进封装及测试扩产，此次设备采购也再度展现资本支出执行力。

日月光投控今年积极扩大AI相关投资，先前已将2026年资本支出规模由70亿美元二度上调至85亿美元，折合人民币逾2,600亿元，创下历史新高；相较原规划，公司额外增加约9亿美元厂房与基础设施支出，以及约6亿美元机器设备投资，重点包括扩充晶圆测试及先进封装产能，提前因应2027年需求。业务运营方面，日月光今年先进封测LEAP业务增长速度优于原先预期，全年营收目标已上调至超过35亿美元，较去年约16亿美元翻倍增长，其中约75%来自先进封装、25%来自测试。公司也持续推进CoWoS全工艺流程、共同封装光学（CPO）及面板级封装（PLP）等布局。

国际半导体设备与材料协会（SEMI）7月14号发布了《年中半导体设备市场预测——OEM视角》，预测全球半导体制造设备销售额将连续第五年增长，到2028年将达到2295亿美元。人工智能驱动的需求正在重塑半导体制造业的投资格局，大量资金正涌入人工智能基础设施、先进逻辑芯片、存储器以及封装等后端技术。今年，全球半导体制造设备原始设备制造商（OEM）的销售额预计将达到创纪录的 1659 亿美元，同比增长 23.2%。按细分市场来看，晶圆制造设备去年的销售额达到 1169 亿美元，创历史新高，预计到 2026 年将增长 23.1%，达到 1439 亿美元。该细分市场包括晶圆加工、光掩模/光罩和晶圆厂设备，这一预测较 SEMI 之前的预期有了显著上调。随着制造商加快产能扩张和技术迁移，SEMI 预测，到 2027 年，该领域的销售额将增长 21.8%，到 2028 年将增长 14.1%，超过 2000 亿美元大关。后端设备市场也蓬勃发展。半导体测试设备销售额在2025年飙升55.3%之后，预计2026年将增长31.0%，达到153亿美元——远高于SEMI此前对2025年底的预测——并有望在2028年进一步增长至208亿美元。

惠科股份投向先进封测

7月17日，惠科股份有限公司发布公告称，公司于2026年7月17日与杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会签署《先进封装及测试项目合作协议》，拟出资40亿元人民币设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司（暂定名），作为项目实施主体，开展先进封装及测试项目。

根据合作协议，项目将分两期建设。其中，项目一期计划建设12寸混合芯片先进封装及测试产线，全部达产后预计达到2000万颗/月的产能规模，项目建设周期不超过三年。项目二期将根据一期实施情况适时启动，具体投资方案、规模及启动时间由双方另行协商确定。

项目公司注册资本为40亿元人民币，惠科股份持有其100%股权。资金来源为公司自有资金，预计将在项目公司设立后2至3年内根据项目建设进度需求分期投入。惠科股份承诺在本协议签订后1个月内完成项目公司的设立，并在项目建成投产后原则上十年内不得擅自进行项目变更。

公司认为，先进封装及测试业务与现有面板业务在技术路线、客户结构、应用场景等方面具有高度协同性。在全球半导体产业供应链重构及国内芯片封装测试市场需求持续增长的背景下，切入先进封装及测试领域是公司向产业链高附加值环节延伸的重要举措，有利于培育新的业务增长极，优化产业结构，提升公司综合竞争力与长期盈利能力。

04 公 司 公 告

研究创造价值

江丰电子:半年度业绩预增公告

7月15日江丰电子发布半年报业绩预告，预计上半年归母净利润4.8亿-5.6亿元，同比大增89.99%-121.65%，扣非净利润预计1.8亿-2.3亿，同比增长2.37%-30.81%，预计上半年实现营业收入约27亿元，较上年同期增长约30%。

报告期内，气体分配盘、真空阀、加热器等核心零部件产品持续放量，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品收入持续增长，国内外客户订单持续增加。另外，公司积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的建设投产，目前黄湖靶材智能工厂所涉厂房已按计划建成，部分车间完成交付，车间智能化立体仓储、柔性自动化单元线、数字化生命周期系统集成等核心模块已完成单体测试，同时韩国江丰靶材工厂主体工程已投入建设。

■ 华峰测控:可转债上市公告、限制性股票激励公告

根据华峰测控发布的向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书，公司发行的74,947.50万元可转换公司债券于7月17日在上交所挂牌交易，如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 336.12 元/股计算，且不考虑发行费用，则公司股东权益增加 74,947.50 万元，总股本增加约 222.98 万股。

根据《北京华峰测控技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，公司同意限制性股票授予日为2026年7月15日，以47.94元/股的授予价格向符合授予条件的119名激励对象授予24.2424万股限制性股票，截至本次授予后，预留部分限制性股票全部授予完毕。此次授予对象主要是职工董事、核心技术人员赵运坤以及董事会认为需要激励的其他人员。

芯原股份:新签订单自愿性披露公告

根据公司的公告，芯原股份延续前期新签订单的强劲增长态势，公司2026年4月30日至2026年7月16日新签订单进一步增长，达到64.13亿元，这部分新签订单中，AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。

2026年1月1日至2026年7月16日，公司新签订单合计146.53亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，相关订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，芯片设计业务订单通常需9-12个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需6-18个月生产周期（即包含产能锁定与排产等待在内的完整生产交付周期），期间逐步实现收入转化。

海光信息:2026年上半年业绩预告

根据海光信息上半年业绩预告公告，公司预计上半年实现营业收入85亿-93亿元，同比增长55.56%到70.20%；预计实现归母净利润17亿-18.3亿，将同比增长41.50%到52.32%，扣非归母净利润15.1亿-17亿，同比增长38.53%到55.96%。

报告期内，公司持续优化“CPU+DCU”业务布局，在人工智能大模型加速迭代、AI Agent应用规模化落地、国产化进程迈向商业化应用的多重驱动下，公司持续加码研发投入、迭代优化产品性能，牢牢把握发展机遇期，推动公司高端处理器产品的市场版图扩展，实现了公司营业收入的快速增长，整体业绩的持续增长。

中颖电子:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书

中颖电子于 7 月 17 日披露 2026 年度向特定对象发行股票修订版募集说明书，本次拟募资总额不超过 10 亿元，项目整体总投资 12.90 亿元，资金分配分为三大板块：1.55 亿元投向高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目，4.25 亿元用于高端工业级（含车规）主控 SoC 研发及产业化，剩余 4.2 亿元补充流动资金；本次发行由控股股东致能工电全额现金认购，募资将集中发力车规、工控高壁垒芯片研发，补齐公司高端产品产能与研发资金缺口，同步优化资本结构，助力公司加速切入新能源汽车、工商业储能等高增长国产替代赛道

本次向特定对象发行股票由公司控股股东致能工电全额认购。假设致能工电认购股票发行上限49407114股，则本次发行完成后，致能工电直接持有公司的股份比例将由14.20%提升至25.05%，有助于公司进一步增强控制权及稳定性。

联芸科技:2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

根据联芸科技发布的半年度业绩预告公告，预计2026年半年度实现营业收入84,969万元左右，较上年同期（法定披露数据）相比，将增加23,997万元左右，同比增加39%左右；预计实现归母净利润51,713万元，同比增加821%左右；预计实现扣非净利润5410万元，同比增加54%左右。

2026年上半年，整体存储市场需求保持增长，行业格局持续优化。公司聚焦存储主控主业，把握行业景气机遇，PCIe 3.0、PCIe 4.0、PCIe 5.0及企业级SATA主控芯片等产品持续受益市场扩容，出货量继续保持稳步增长。公司在新产品开发及量产方面取得阶段性进展，存储主控芯片PCIe 5.0芯片支持NVMe 2.1协议及新一代LDPC纠错技术，性能较上一代产品提升近一倍，已在OEM厂商端量产；UFS 3.1主控芯片实现对QLC NAND支持，在NAND价格上行周期中可有效降低客户整体存储成本；企业级PCIe 5.0主控芯片已处于量产测试阶段，相关研发工作有序推进，目前尚未贡献营收，后续量产节奏及业绩贡献存在一定不确定性。此外，公司新一代车载感知信号处理芯片满足4D成像毫米波应用要求，适配L2+及以上高阶辅助驾驶应用，2026年初完成客户导入，第二季度出货逐步推进。

佰维存储:上半年业绩预告自愿性披露公告

深圳佰维存储科技股份有限公司预计2026年半年度实现营业收入150亿-160亿元，同比增长283.4%-308.96%，预计实现归母净利润70亿-75亿元，同比增加3200.15%至3421.59%，预计实现扣非归母净利润62亿-70亿元，同比增加2776.26%至3121.59%。

本期业绩大幅增长，主要受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期，公司的产品和客户结构持续优化，同时公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域不断加大投入力度，增强市场竞争力

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研创造价值